

## 3.2 W 单声道D类音频功率放大器支持 可选增益和自动恢复短路保护

 查询样品: [TPA2038D1](#)

### 特性

- 无滤波器单声道D类扬声器放大器
- **GAIN** 引脚在 **6 dB** 和 **12 dB**之间进行选择
- **5 V** 电源供电时, 可为 **4 Ω** 负载提供 **3.2 W** 连续功率, 总谐波失真(THD)+N 小于 **10%**
- 功能强大的单声道 **D** 类扬声器放大器
  - **5 V** 电源供电时, 可为 **8 Ω** 负载提供 **1.4 W** 连续功率, 总谐波失真(THD)小于 **1%**
  - **5 V** 电源供电时, 可为 **4 Ω** 负载提供 **2.5 W** 连续功率, 总谐波失真(THD)小于 **1%**
- 集成图像抑制滤波器用于降低 **DAC** 噪声
- **20 μV** 低输出噪声
- **1.5 mA** 低静态电流
- 自动恢复短路保护
- 过热保护
- **9-焊球 1,21 mm × 1,16 mm 0,4 mm 间距 WCSP**

### 应用范围

- 无线或蜂窝手机及 **PDA**
- 便携式导航设备
- 通用便携式音频设备

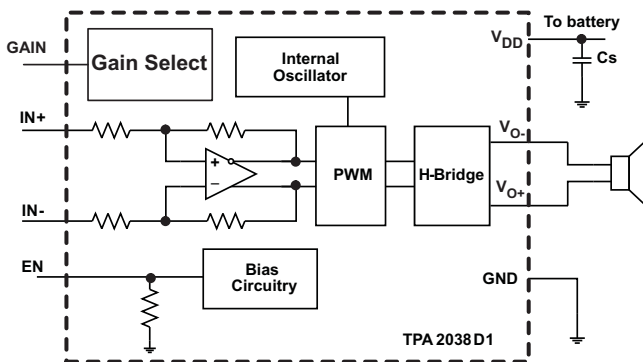
### 说明

TPA2038D1 是一款可为 **8 Ω** 负载提供 **3.2 W** 连续功率 (总谐波失真 (THD) 小于 **10%**) 的高有效性无滤波器D类音频功率放大器。 **GAIN** 引脚可将增益设置在 **6 dB** 或 **12 dB**。

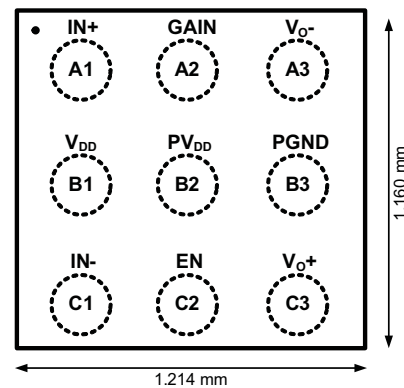
诸如 **95%** 有效性, **1.5 mA** 静态电流, **0.5 μA** 关闭电流, **81 dB PSRR**, **20 μV** 输出噪音, 和改进的 **RF** 抗扰使得 TPA2038D1 D类放大器成为手持电话的理想选择。 启动时间在 **4 ms** 之内并且无开启爆破声。

TPA2038D1采用 **1.21 mm x 1.16 mm, 0.4 mm** 间距晶圆级芯片尺寸封装 (WCSP)。

### 应用电路



TPA2038D1  
9-BALL 0.4mm PITCH  
WAFER CHIP SCALE PACKAGE (YFF)  
(TOP VIEW OF PCB)



### THERMAL INFORMATION



Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

**THERMAL INFORMATION (continued)**

THERMAL METRIC <sup>(1)</sup>			
		PINS	UNITS
$\theta_{JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance <sup>(2)</sup>		°C/W
$\theta_{JcTop}$	Junction-to-case (top) thermal resistance <sup>(3)</sup>		
$\theta_{JB}$	Junction-to-board thermal resistance <sup>(4)</sup>		
$\psi_{JT}$	Junction-to-top characterization parameter <sup>(5)</sup>		
$\psi_{JB}$	Junction-to-board characterization parameter <sup>(6)</sup>		
$\theta_{JcBot}$	Junction-to-case (bottom) thermal resistance <sup>(7)</sup>		

- (1) 有关传统和新的热量的更多信息，请参阅 *IC* 封装热量量 应用报告 [SPRA953](#)。
- (2) 在 JESD51-2a 描述的环境中，按照 JESD51-7 的指定在一个 JEDEC 标准 high-K 测试电路板上进行仿真，从而获得自然对流条件下的结到外部热阻。
- (3) 通过在封装顶部进行冷板测试仿真来获得结到芯片外壳（顶部）热阻。不存在特定的 JEDEC 标准测试，但可在 ANSI SEMI 标准 G30-88 中找到内容接近的说明。
- (4) 按照 JESD51-8 中的说明，通过在配有用于控制 PCB 温度的环形冷板夹具的环境中进行仿真，以获得结到电路板热阻。
- (5) 结到顶部的表征参数 ( $\psi_{JT}$ ) 估算真实系统中器件的结温，并使用 JESD51-2a（第 6 章和第 7 章）中描述的程序从得到  $\theta_{JA}$  的仿真数据中提取出该参数。
- (6) 结到电路板的表征参数 ( $\psi_{JB}$ ) 估算真实系统中器件的结温，并使用 JESD51-2a（第 6 章和第 7 章）中描述的程序从得到  $\theta_{JA}$  的仿真数据中提取出该参数。
- (7) 通过在裸（电源）焊盘上进行冷板测试仿真来获得结到芯片外壳（底部）热阻。不存在特定的 JEDEC 标准测试，但在 ANSI SEMI 标准 G30-88 中找到了内容接近的说明。

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable Device	Status <sup>(1)</sup>	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan <sup>(2)</sup>	Lead/ Ball Finish	MSL Peak Temp <sup>(3)</sup>	Samples (Requires Login)
TPA2038D1YFFR	ACTIVE	DSBGA	YFF	9	3000	Green (RoHS & no Sb/Br)	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	
TPA2038D1YFFT	ACTIVE	DSBGA	YFF	9	250	Green (RoHS & no Sb/Br)	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	

<sup>(1)</sup> The marketing status values are defined as follows:

**ACTIVE:** Product device recommended for new designs.

**LIFEBUY:** TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

**NRND:** Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

**PREVIEW:** Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

**OBsolete:** TI has discontinued the production of the device.

<sup>(2)</sup> Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check <http://www.ti.com/productcontent> for the latest availability information and additional product content details.

**TBD:** The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.

**Pb-Free (RoHS):** TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.

**Pb-Free (RoHS Exempt):** This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.

**Green (RoHS & no Sb/Br):** TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material)

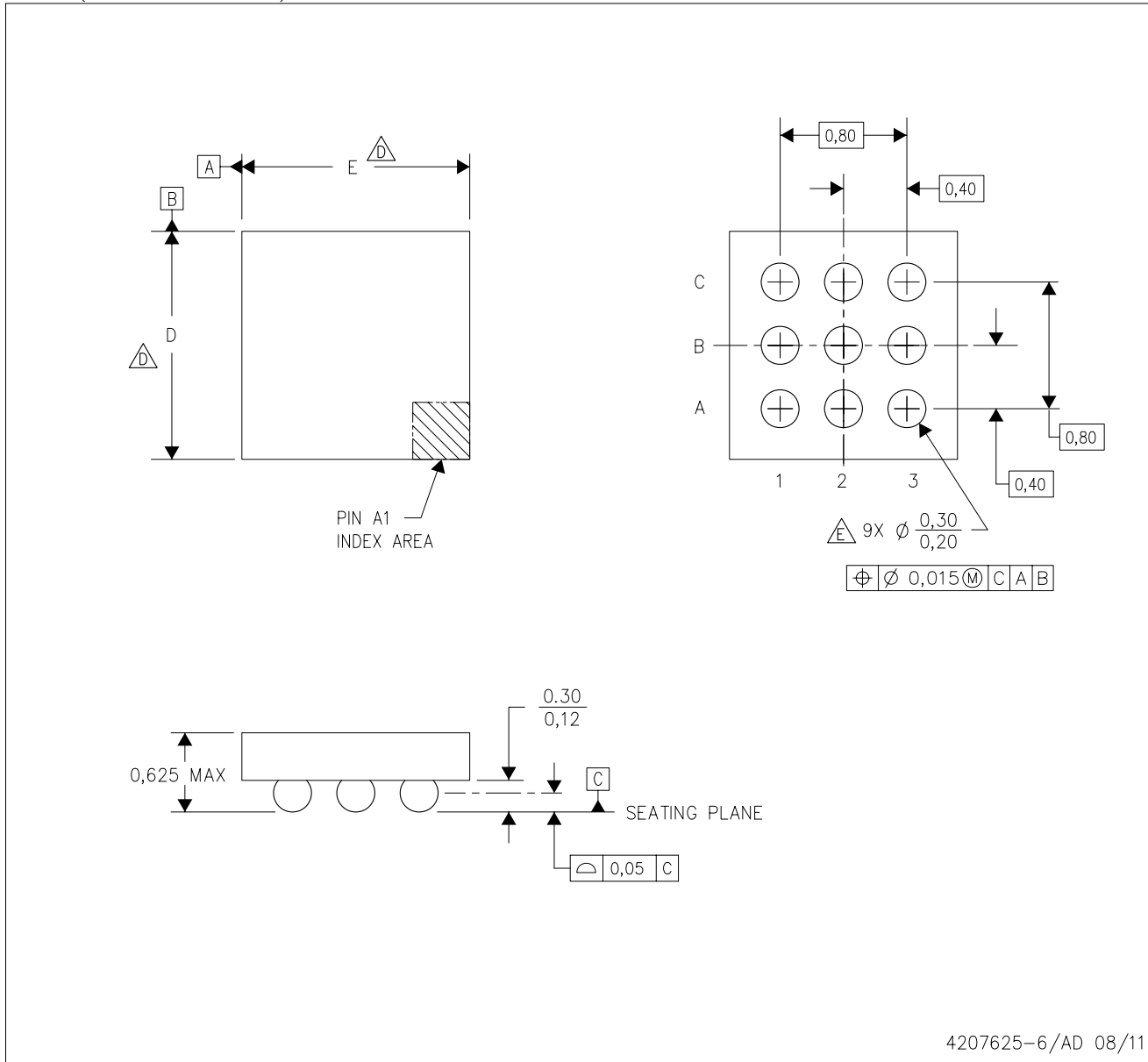
<sup>(3)</sup> MSL, Peak Temp. -- The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

YFF (S-XBGA-N9)

DIE-SIZE BALL GRID ARRAY



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M-1994.
  - B. This drawing is subject to change without notice.
  - C. NanoFree™ package configuration.
  - $\triangle$  The package size (Dimension D and E) of a particular device is specified in the device Product Data Sheet version of this drawing, in case it cannot be found in the product data sheet please contact a local TI representative.
  - E. Reference Product Data Sheet for array population.  
3 x 3 matrix pattern is shown for illustration only.
  - F. This package contains Pb-free balls.

NanoFree is a trademark of Texas Instruments



## 重要声明

德州仪器(TI) 及其下属子公司有权在不事先通知的情况下, 随时对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 并有权随时中止提供任何产品和服务。客户在下订单前应获取最新的相关信息, 并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的TI 销售条款与条件。

TI 保证其所销售的硬件产品的性能符合TI 标准保修的适用规范。仅在TI 保证的范围内, 且TI 认为有必要时才会使用测试或其它质量控制技术。除非政府做出了硬性规定, 否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

TI 对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用TI 组件的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险, 客户应提供充分的设计与操作安全措施。

TI 不对任何TI 专利权、版权、屏蔽作品权或其它与使用了TI 产品或服务的组合设备、机器、流程相关的TI 知识产权中授予的直接或隐含权限作出任何保证或解释。TI 所发布的与第三方产品或服务有关的信息, 不能构成从TI 获得使用这些产品或服务的许可、授权、或认可。使用此类信息可能需要获得第三方的专利权或其它知识产权方面的许可, 或是TI 的专利权或其它知识产权方面的许可。

对于TI 的产品手册或数据表, 仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

在转售TI 产品或服务时, 如果存在对产品或服务参数的虚假陈述, 则会失去相关TI 产品或服务的明示或暗示授权, 且这是非法的、欺诈性商业行为。TI 对此类虚假陈述不承担任何责任。

TI 产品未获得用于关键的安全应用中的授权, 例如生命支持应用(在该类应用中一旦TI 产品故障将预计造成重大的人员伤亡), 除非各方官员已经达成了专门管控此类使用的协议。购买者的购买行为即表示, 他们具备有关其应用安全以及规章衍生所需的所有专业技术和知识, 并且认可和同意, 尽管任何应用相关信息或支持仍可能由TI 提供, 但他们将独力负责满足在关键安全应用中使用其产品以及TI 产品所需的所有法律、法规和安全相关要求。此外, 购买者必须全额赔偿因在此类关键安全应用中使用TI 产品而对TI 及其代表造成的损失。

TI 产品并非设计或专门用于军事/航空应用, 以及环境方面的产品, 除非TI 特别注明该产品属于“军用”或“增强型塑料”产品。只有TI 指定的军用产品才满足军用规格。购买者认可并同意, 对TI 未指定军用的产品进行军事方面的应用, 风险由购买者单独承担, 并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

TI 产品并非设计或专门用于汽车应用以及环境方面的产品, 除非TI 特别注明该产品符合ISO/TS 16949 要求。购买者认可并同意, 如果他们在汽车应用中使用任何未被指定的产品, TI 对未能满足应用所需要求不承担任何责任。

可访问以下URL 地址以获取有关其它TI 产品和应用解决方案的信息:

	产品		应用
数字音频	<a href="http://www.ti.com.cn/audio">www.ti.com.cn/audio</a>	通信与电信	<a href="http://www.ti.com.cn/telecom">www.ti.com.cn/telecom</a>
放大器和线性器件	<a href="http://www.ti.com.cn/amplifiers">http://www.ti.com.cn/amplifiers</a>	计算机及周边	<a href="http://www.ti.com.cn/computer">www.ti.com.cn/computer</a>
数据转换器	<a href="http://www.ti.com.cn/dataconverters">http://www.ti.com.cn/dataconverters</a>	消费电子	<a href="http://www.ti.com/consumer-apps">www.ti.com/consumer-apps</a>
DLP® 产品	<a href="http://www.dlp.com">www.dlp.com</a>	能源	<a href="http://www.ti.com/energy">www.ti.com/energy</a>
DSP - 数字信号处理器	<a href="http://www.ti.com.cn/dsp">http://www.ti.com.cn/dsp</a>	工业应用	<a href="http://www.ti.com.cn/industrial">www.ti.com.cn/industrial</a>
时钟和计时器	<a href="http://www.ti.com.cn/clockandtimers">http://www.ti.com.cn/clockandtimers</a>	医疗电子	<a href="http://www.ti.com.cn/medical">www.ti.com.cn/medical</a>
接口	<a href="http://www.ti.com.cn/interface">http://www.ti.com.cn/interface</a>	安防应用	<a href="http://www.ti.com.cn/security">www.ti.com.cn/security</a>
逻辑	<a href="http://www.ti.com.cn/logic">http://www.ti.com.cn/logic</a>	汽车电子	<a href="http://www.ti.com.cn/automotive">www.ti.com.cn/automotive</a>
电源管理	<a href="http://www.ti.com.cn/power">http://www.ti.com.cn/power</a>	视频和影像	<a href="http://www.ti.com.cn/video">www.ti.com.cn/video</a>
微控制器 (MCU)	<a href="http://www.ti.com.cn/microcontrollers">http://www.ti.com.cn/microcontrollers</a>	无线通信	<a href="http://www.ti.com.cn/wireless">www.ti.com.cn/wireless</a>
RFID 系统	<a href="http://www.ti.com.cn/rfidsys">http://www.ti.com.cn/rfidsys</a>		
RF/IF 和 ZigBee® 解决方案	<a href="http://www.ti.com.cn/radiofre">www.ti.com.cn/radiofre</a>		
	TI E2E 工程师社区		<a href="http://e2e.ti.com/cn/">http://e2e.ti.com/cn/</a>

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号, 中建大厦 32 楼 邮政编码: 200122  
Copyright © 2011 德州仪器 半导体技术 (上海) 有限公司

[www.BDTIC.com/TI](http://www.BDTIC.com/TI)